

マニュアルボールワイヤーボンダ

LED ペアチップ(数百 μm 角)等の半導体と回路基板を熱と圧力と超音波によって結線する装置

【型式】

WESTBOND 7700D

【仕様】

ボンディング方式	: US・TC 又はサーモニック方式
操作方法	: 3 軸マニピュレータ
荷重	: 10~100g
超音波	: 最大 4W、999ms、63kHz (固定)
金線	: 25 μm ϕ
ワークホルダー範囲	: 最大 50mm \times 50mm
搭載機構	: デュアルフォース機構、ボールサイズコントローラー、 温度コントローラー、ワイヤーディスプーラー

【設置年度】

2012 年度 (平成 24 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日